

河南新型软硬结合板功率

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：22

LED开关电源的研发速度在近几年中有了明显的技术飞跃，新产品更新换代的速度也加快了许多。作为后面一个设计环节，软硬结合板的设计也显得尤为重要，因为一旦在这一环节出现问题，那么很可能对整个的LED开关电源系统产生较多的电磁干扰，对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么PCB的设计怎样做才是正确的呢？通过近几年中LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明，即使在研发初期所设计的电路原理图是非常正确，然而一旦软硬结合板的设计出现问题，也会对电子设备的可靠性产生不利影响，例如由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰，就会使产品的性能下降，因此在设计PCB板的时候，就需要采用正确的方法。

0.8 四层软硬结合板的压板结构和参数是什么，在什么地方可以查到。河南新型软硬结合板功率

软硬结合板设计的检查项目-PCB checklist:

二、布局后检查阶段:

7, 与结构相关的器件布好局后锁住，防止误操作移动位置.

8, 压接插座周围5mm范围内，正面不允许有高度超过压接插座高度的元件，背面不允许有元件或焊点.

9, 确认器件布局是否满足工艺性要求（重点关注BGA、PLCC、贴片插座）.

10, 金属壳体的元器件，特别注意不要与其它元器件相碰，要留有足够的空间位置.

11, 接口相关的器件尽量靠近接口放置，背板总线驱动器尽量靠近背板连接器放置.

12, 波峰焊面的CHIP器件是否已经转换成波峰焊封装，

13, 手工焊点是否超过50个.

福建集成软硬结合板哪几种rogers 4350板材的软硬结合板可以做么？

射频软硬结合板电路板设计的几个要点：

4、电源去耦电路

B: 这些去耦组件的位置通常也很关键。这几个重要组件的布局原则是

C4要尽可能靠近IC接脚并接地

C3必须靠近C4

C2必须靠近C3

而且IC接脚与C4的连接走线要尽可能短，这几个组件的接地端（尤其是C4）通常应当藉由板面下一个接地层与芯片的接地脚相连。将组件与接地层相连的过孔应该尽可能靠近PCB板上的组件焊盘，是使用打在焊盘上的盲孔将连接线电感减小，电感L1应该靠近C1

一个集成电路或放大器常常具有一个集电极开路输出（open collector）因此需要一个上拉电感（pullup inductor）来提供一个高阻抗RF负载和一个低阻抗直流电源，同样的原则也适用于对这一电感的电源端进行去耦。有些芯片需要多个电源才能工作，因此可能需要两到三套电容和电感来分别对它们进行去耦处理，如果该芯片周围没有足够的空间，那么去耦效果可能不好。尤其需要特别注意的是：电感极少平行靠在一起，因为这将形成一个空芯变压器，并相互感应产生干扰信号，因此它们之间的距离至少要相当于其中之一的高度，或者成直角排列以使其互感减到较小。

好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计软硬结合板时，每个集成电路的电源，地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作

用：一方面是本集成电路的蓄能电容，提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能；另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为0.1uF的去耦电容有5nH分布电感，它的并行共振频率大约在7MHz左右，也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用，对40MHz以上的噪声几乎不起作用。基站用的各种软硬结合板板材有多少种，都齐全嘛？

软硬结合板设计的检查项目-PCB checklist:一、资料输入阶段:1. 在流程上接收到的资料是否齐全（包括：原理图*.brd文件、料单*PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件）2. 确认PCB模板是新的3. 确认模板的定位器件位置无误4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5. 确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6. 比较外形图，确认PCB所标注尺寸及公差无误，金属化孔和非金属化孔定义准确7. 确认PCB模板准确无误后应当锁定该结构文件，以免误操作被移动位置. 普通四层软硬结合板，第二层满是地，表层做50欧姆阻抗线（两侧紧邻表层的铺地），请问线宽是多少mil?广东PCB软硬结合板诚信推荐

10层软硬结合板从下单到收货需要多少时间？河南新型软硬结合板功率

软硬结合板元件布局基本规则:1. 按电路模块进行布局，实现同一功能的相关电路称为一个模块，电路模块中的元件应采用就近集中原则，同时数字电路和模拟电路分开；2. 定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm内不得贴装元、器件，螺钉等安装孔周围3.5mm*对于M2.5*4mm*对于M3*内不得贴装元器件；3. 卧装电阻、电感（插件）、电解电容等元件的下方避免布过孔，以免波峰焊后过孔与元件壳体短路；4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm*5.贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm*6.金属壳体元器件和金属件（屏蔽盒等）不能与其它元器件相碰，不能紧贴印制线、焊盘，其间距应大于2mm*定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm*河南新型软硬结合板功率

深圳市宝利峰实业有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在广东省等地区的数码、电脑中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来深圳市宝利峰实业供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！